

# SEMICON<sup>®</sup> JAPAN

DEC 13 – 15, 2017  
TOKYO, JAPAN

## 参加報告書

群馬大学大学院 理工学府  
理工学専攻 電子情報・数理教育  
小林研究室 博士前期課程 1年  
MANIMEL WADU SAHAN DULARA (サハン)

- 参加イベント

セミコンジャパン 2017 <http://www.semiconjapan.org/>

- 開催場所

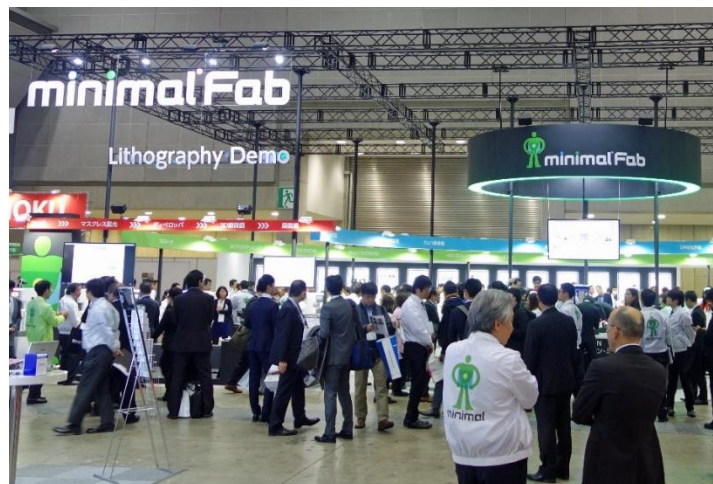
東京ビッグサイト、国際展示所、東京

- 開催期間

2017/12/13 (水) ~12/15 (金)

- セミコンジャパン 2017

12月13日(水)~15日(金)にかけて東京ビッグサイトで「SEMICON JAPAN 2017 (セミコン・ジャパン)」が開催されました。多様セミナーやイベントが数多く開催されました世界最大級のエレクトロニクス製造サプライチェーン総合展示会です。



## ● 群馬大学小林春夫研究室ブース

私は初めてセミコンジャパンに参加させていただき、貴重な経験を体験できました。我々のブースの説明者として姚さん、熊さんと私が参加しました。今年には群馬大学アナログ集積回路研究会をテーマにしていました。研究室の展示は下記ポスターになります。

小島さん： $\Delta\Sigma$  デジタル・アナログ変換器のデジタル信号処理を用いた線形性向上アルゴリズム

栗原さん：Electron Mobility Modeling of AlN/GaN MIS-HEMTs  
With Embedded Source Field-Plate Structures

田村さん：高周波信号処理用アナログヒルベルトフィルタの理論検討

莉乃さん：90nm NMOSFET の速度飽和パラメータ新抽出方法

町田さん：異なる周期をもつ非同期な2つの正弦波を用いた時間デジタル化回路

また、私は未来 COLLEGE に参加し、様々な大学の学生と交流できました。また、スポンサー企業様は研究室の学生とお話できる機会を自ら提供され、就職活動にも役に立つ意見を聞き、悩みなどを解決できました。



## ● 株式会社 新川

新川さんの説明会に参加し、半導体の配線のボンディングの詳しい説明を受けました。同社のブースに足を運び、実際に半導体のボンディングするところを見て感動しました。高速できれいにボンディングしている優れた技術をすごく気に入りました。

- **セミコン会場ブースツアー**

企業各社の最新技術や製品を展示しているブースの見学ができました。  
普段目にする事ができない半導体製造関連の最新技術が実際に見ることができました。  
さらに、学生の方々向けの説明会で半導体に関する知識を分かりやすく教えてくれました。



- **帰りに**

セミコンジャパンが終わりましたらお台場のイルミネーションを見にいきました。  
久しぶりにお台場のイルミネーションをみて感動しました。



- **感謝**

今回セミコンジャパンの出展を与えて頂き、小林春夫先生、未来 COLLEGE の登録に関する手配を行って頂いた SEMI ジャパンの吉田さん、交通費にサポートくださった株式会社新川の皆様に深く感謝を申し上げます。

また、小林春夫研究室ブースにお立ち寄りいただいた皆様、ご来場誠にありがとうございました。